

SEMI G75.12-0698 (Reapproved 0706)

リードフレームテープの絶縁破壊強度の測定のための試験方法

NOTICE: This translation is a REFERENCE COPY ONLY. If differences should exist between the English version and a translation in any other language, the English version is the official and authoritative version.

免責事項： この SEMI スタンドアードは、投票により作成された英語版が正式なものであり、日本語版は日本の利用者各位の便宜のために作成したものです。万が一英語と日本語とに差異がある場合には英語版記載内容が優先されます。

SEMI スタンドアード日本語翻訳版をご利用にあたっての注釈を本文の末尾に記載しております(「すべきである」「しなければならない」について等)。

本スタンドアードは、Assembly & Packaging Global Technical Committee で技術的に承認されている。現版は 2006 年 5 月 16 日、global Audits and Reviews Subcommittee にて発行が承認された。2006 年 6 月に www.semi.org で。初版は 1998 年 6 月発行。

1 方法の要約

1.1 リードフレームテープの表裏の両面に電極を設置し、電圧を印加する。電流の大幅な上昇と電圧降下直前の電圧を絶縁破壊強度として測定する。

2 装置

2.1 電源 – 直流高電圧発生器 (50 kv 能力)

2.2 電極 – 周辺のエッジが 2.5 mm の半径に丸められている、12.5 mm の直径の真鍮球状電極、および 25 mm の直径の真鍮電極 (図 1 参照)。

2.3 マイクロメーター 精度 0.001 mm

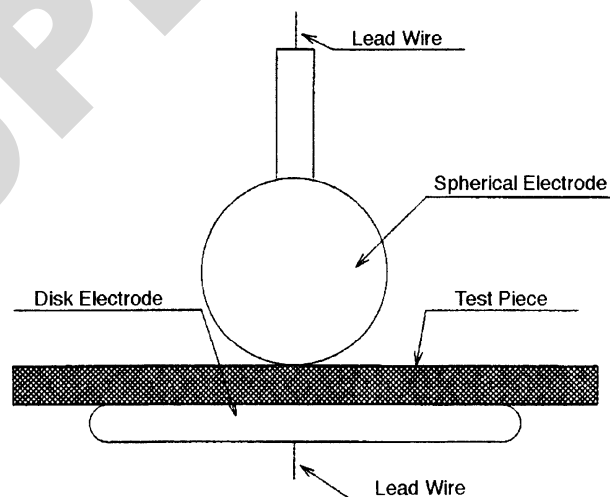


図 1
破壊強度測定のための電極

3 サンプルング

3.1 サンプルングは、1 ロットあたり 1 サンプルである。ユーザが要求するならば、メーカーは、ロットの定義を報告しなければならない。

4 試料の調整

4.1 試料の寸法がディスク電極の直径よりも大きくなるように、試料をテープサンプルから切り取る。

4.2 試料は、 90 ± 2 時間、 $23^\circ \pm 5^\circ\text{C}$ と $50 \pm 5\%$ RH で放置する。

5 テスト条件

5.1 温度 – $23^\circ \pm 5^\circ\text{C}$

5.2 相対湿度 – $50 \pm 5\%$ RH

6 手順

6.1 ディスク電極上に試料を置き、テープの上に球状電極を置く。電極とテープの間の良好な接触を確保する。

6.2 試料のセットアップ

6.2.1 電源を入れて、破壊が発生するまで、一定の上昇速度で電圧を増加させる。

注 1: 破壊時の電圧に注意する。次に測定する試料においては、電圧印加の開始後から約 10~20 秒以内に破壊が生じるように、電圧上昇速度を調整する。

6.3 すべての試料について、その測定を繰り返す。

6.4 マイクロメータを用いて試料の厚さを測定する。

6.5 計算

6.5.1 絶縁破壊強度は、次式によって計算されるべきである：

$$\text{絶縁破壊強度} \left(\frac{\text{kv}}{\text{mm}} \right) = \frac{V_{BD}}{t}$$

ここで：

V_{BD} = 破壊電圧 (kv)

t = テープ厚さ (mm)

7 関連文書

7.1 ASTM 仕様¹

ASTM D257 — Standard Test Methods for D-C Resistance or Conductance of Insulating Materials

7.2 JIS 仕様²

JIS K 6911 — Testing Methods for Thermosetting of Plastics

¹ ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428-2959, USA; Telephone: +1.610.832.9585, Fax: +1.610.832.9555, <http://www.astm.org>

² Japanese Standards Association, Mita MT Bldg., 3-13-2 Mita, Minato-ku, Tokyo 108-0073, Japan; Telephone: +81.3.3583.8005, Fax: +81.3.3586.2014, <http://www.jsa.or.jp>